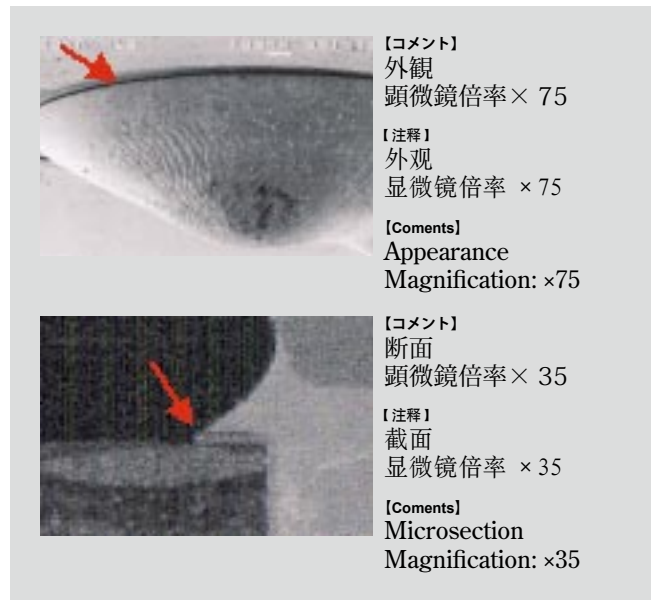




10-1-2 ランド剥離／焊环的剥离 / Lifted land

【特徴】 ランドと基板樹脂間が剥離してその部分が浮き上がっている状態の欠陥

【特征】 焊环从板的树脂分离，该部分浮起的缺陷。

【Characteristics】 A land is separated and lifted from the base material.

【起因・判断ポイント・発生工程】 部品実装時または熱衝撃試験などでの熱ストレスや、それにより発生した機械的応力の影響を受けて出来たもの（電子部品実装工程、熱衝撃試験）

【原因、判断要点、発生工序】 受元件封装时或者热冲击试验时等的热应力，以及机械应力的影响所引起的（元件封装工序、热冲击试验）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 The defect is caused by thermal stress and/or mechanical stress induced in component mounting or thermal shock testing (Component mounting process and thermal shock test)

